tSML - Blindplatte Snap-In für Modul 19''/0.5HE

\*\*tSML - tde Semi Modular Link

tSML ist ein modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus zwei Kernkomponenten besteht: Modul und Trunkkabel. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die LWL und TP Module können mit ihren Abmessungen von 19" 0,5HE zusammen innerhalb einer Höheneinheit mit sehr hoher Portdichte kombiniert eingesetzt werden. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports sind so auf 1HE möglich. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP® und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.

\*\*tSML - LWL/TP Breakout Modul Zubehör

Zur Abdeckung nicht benötigter Slots. Es können beim tSML - Modul 19"/0.5HE 4x Blindplatten eingesetzt werden.

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Material | Edelstahl |
| Befestigung | Snap-In frontseitig im tSML - Modul |
|  | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |